



(10) **DE 11 2017 005 688 A5** 2019.08.22

(12)

Hinweis auf die internationale Veröffentlichung in deutscher Sprache

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung
in deutscher Sprache: **WO 2018/087297**
(21) Deutsches Aktenzeichen: **11 2017 005 688.8**
(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/EP2017/078899**
(86) PCT-Anmeldetag: **10.11.2017**
(87) PCT-Veröffentlichungstag: **17.05.2018**

(51) Int Cl.: **H01L 33/62** (2010.01)
H01L 33/48 (2010.01)

(66) Innere Priorität:
10 2016 121 631.3 **11.11.2016**
(71) Anmelder:
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93055
Regensburg, DE**

(74) Vertreter:
**Epping Hermann Fischer
Patentanwaltsgesellschaft mbH, 80639 München,
DE**

(72) Erfinder:
**Leirer, Christian, Dr., 86316 Friedberg, DE;
Behringer, Martin Rudolf, Dr., 93049 Regensburg,
DE**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Löt pads variabler Dicke in optoelektronischem Halbleiterchip, auf einem Anschlussträger für die Montage eines Halbleiterchips, Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils und optoelektronisches Bauteil mit diesen Löt pads**

Der vollständige Inhalt der PCT-Anmeldung ist der Original-Veröffentlichung der WIPO (in deutscher Sprache) zu entnehmen. Die WO-Veröffentlichung mit der Veröffentlichungsnummer der PCT-Anmeldung unter INID-Code (87) kann unter <https://depatisnet.dpma.de> eingesehen werden.